





晶振在制程过程中要求将内部抽真空后充满氮气，如果出现压封不良，导致晶振气密性不好出现漏气;或者晶振在焊接过程中因为剪脚等过程中产品的机械应力导致晶振出现气密性不良;均会导致晶振出现不起振的现象。

解决办法:更换好的晶振。在制程和焊接过程中一定要规范作业，避免误操作导致产品损坏。6、焊接时温度过高或时间过长，导致晶振内部电性能指标出现异常而引起晶振不起振

以32.768KH直插型为例，要求使用178 ° 熔点的焊锡，晶振内部的温度超过150C，会引起晶振特性的恶化或者不起振。焊接引脚时，280 ° C下5秒以内或者260 ° 以下10秒以内。

不要在引脚的根部直接焊接，这样也会导致晶振特性的恶化或者不起振。

解决办法:焊接制程过程中一定要规范操作，对焊接时间和温度的设定要符合晶振的要求。如有疑问可与我们联系确认。7、储存环境不当导致晶振电性能恶化而引起不起振

在高温或者低温或者高湿度等条件下长时间使用或者保存，会引起晶振的电性能恶化，可能导致不起振。解决办法:尽可能在常温常湿的条件下使用、保存，避免晶振或者电路板受潮。

8、MCU质量问题、软件问题等导致晶振不起振

解决办法:目前市场上面MCU遂新货、翻新货、拆机货、贴牌货等鱼龙混杂，如果没有一定的行业经验或者选择正规的供货商，则极易买到非\*。这样电路容易出现问題，导致振荡电路不能工作。另外即便是\*\* MCU，如果烧录程序出现问題，也可能导致晶振不能起振。

9、EMC问題导致晶振不起振

解决力法:一般而言，金属封装的制品在抗电磁干扰上\*\*陶瓷封装制品，如果电路上EMC较大，则尽量选用金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线，避免带来干扰。

10、其他问題导致晶振不起振